

Wichtige Ereignisse im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2005

Automobil- und Industrieelektronik

- Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2005 kündigte der Geschäftsbereich an, über die nächsten Jahre etwa eine Milliarde Euro für ein neues Front-End-Werk in Malaysia zu investieren. Am neuen Standort sollen hauptsächlich Leistungshalbleiter für den Einsatz in Automobil- und Industrieanwendungen gefertigt werden. Die Bauarbeiten beginnen im Frühjahr 2005; der Hochlauf des Werks ist für 2006 geplant. Bei voller Auslastung der Anlage werden voraussichtlich 1.700 Mitarbeiter im Werk beschäftigt.
- Auf Grund der gestiegenen Nachfrage und trotz der beträchtlichen Auswirkungen der Dollar-Schwäche konnte Infineon in diesem Zeitraum seinen Marktanteil für MOSFETs in PC-Motherboards auf über 30 Prozent steigern.

Drahtgebundene Kommunikation

- Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2005 erzielte der Geschäftsbereich Design-Wins bei großen Kunden mit seinem neuen ADSL CPE-Chip AMAZON für Breitband-Teilnehmeranschlusseinrichtungen.
- Einen bedeutenden Design-Win verzeichnete der Geschäftsbereich auch mit dem SHDSL-Chip von Infineon bei einem großen Kunden in den USA.
- Das Unternehmen präsentierte zudem mit Wild-TriPlay ein Home-Gateway-Referenzsystem, das eine komplette Plattform mit Hardware und Software für Triple-Play-Anwendungen (Sprache, Video und Daten) bereitstellt.

Sichere Mobile Lösungen

- Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2005 hat der Geschäftsbereich Sichere Mobile Lösungen im asiatisch-pazifischen Raum erfolgreich den ersten Single-Chip CMOS GPRS-Transceiver mit der Bezeichnung SMARTi SD2 eingeführt.
- Infineon hat mit BlueMoon UniCellular einen sehr energiesparenden und zudem den kleinsten Bluetooth-Chip der Branche vorgestellt. Der Chip erreicht im Vergleich zu klassischen Bluetooth-Lösungen die dreifache Datenrate.
- Infineon hat außerdem seinen Kundenstamm im Bereich drahtlose Infrastruktur ausgeweitet. Dazu gehörte unter anderem auch ein erster Design-Win in China.
- Im Geschäftsbereich Sicherheitslösungen hat Infineon als erster Anbieter einen High-End-Mikrokontroller mit einem Megabyte Flash-Speicher vorgestellt. Der Chip wird in mobilen Kommunikations- und anderen Anwendungen eingesetzt, in denen die erhöhte Speicherkapazität einen großen Vorteil darstellt. Für den Chip hat Infineon den angesehenen Sesames Award der Chipkarten-Industrie für die beste Hardware-Innovation erhalten.

Speicherprodukte

- Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2005 hat Infineon anlässlich des 2004 IEEE International Electronical Devices Meeting in San Francisco seine 70-Nanometer-Trench-Technologie präsentiert. Einige der dort gezeigten Innovationen haben sich bereits in der Produktion mit der 90-Nanometer-Technologie bewährt.
- Der Übergang von Produkten vom Entwicklungsstadium in die Volumenfertigung auf Basis der 90-Nanometer-Technologie hat gute Fortschritte gemacht. Infineon war der zweite DRAM-Hersteller, der für ein auf der 90-Nanometer-Technologie basierendes DRAM-Produkt die Zertifizierung von Intel erhalten hat. Die Ausbeute von 300-Millimeter-Wafern wurde weiter verbessert und entspricht heute der von 200-Millimeter-Wafern.
- Der Geschäftsbereich Speicherprodukte hat sein Produktportfolio auch in diesem Zeitraum weiter vergrößert. Infineon ist der erste Anbieter von 256-Megabyte- und 512-Megabyte-Micro-DIMMs für Subnotebooks sowie von 512-Megabit-Mobile-RAMs mit DDR-Interface. Muster von Fully-buffered DIMMs und ein neuer 256-Megabit-DDR2-Grafik-RAM mit Taktfrequenzen von bis zu 400 Megahertz wurden an Kunden verschickt.